

Low Noise GaAsFET(MM34, CK24, CK34 Package)

赤外線リフロー方式のはんだ付け推奨条件

Recommended Soldering Conditions of Infrared Reflow

[温風、赤外線+温風リフローを含む]

[Hot Air, Infrared + Hot Air Reflow Included]

KMR-CEF-0146

1/1

2016年 6月 20日

中央電子工業株式会社
電子デバイス事業部
Chuo Denshi Kogyo Co., Ltd
Electronic Devices Division

赤外線リフロー方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。

The following is recommended soldering conditions of infrared reflow.

- ・最高温度 (パッケージ表面温度)
Peak temperature (package surface temperature) : 260℃以下
: 260℃ or below
- ・最高温度の時間
Time at peak temperature : 10sec 以内
: 10seconds or less
- ・220℃以上の時間
Time at temperature of 220℃ or higher : 60sec 以内
: 60seconds or less
- ・プリヒート温度 (120～180℃の時間)
Preheating time at 120 to 180℃ : 120±30sec
: 120±30seconds
- ・最多リフロー回数
Maximum number of reflow processes : 3 回
: 3 times
- ・ロジン系フラックスの塩素含有量
Maximum chlorine content of rosin flux (% mass) : 0.2% (Wt.) 以下
: 0.2% (Wt.) or below

